

### Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu		35	
2	Tr-Lam	0.36		
	Cu		35	
3	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
4	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
	Prepreg	0.048		106
5	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
	Cu		35	
6	Tr-Lam	0.36		
	Cu		35	
7	Prepreg	0.068		1080
	Prepreg	0.068		1080
8	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke*	1,57	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske*	1,68	+/- 10%

### Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- \* Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 thermostabil, gefüllt bei 50% Kupferbelegung auf

Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)

- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

## Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Kernbohrungen [B] (blind buried Vias)	End-Ø	250 µm
	Viapad-Ø	≥ 550 µm
Leiterbild Außenlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
Leiterbild galvanisierte Innenanlagen	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 110 µm

[Download PDF](#)

Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 115 µm ≥ 130 µm
Leiterbild Innenlagen	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm ≥ 100 µm